

## 信頼性試験結果 Reliability Test

XCL225 シリーズ  
XCL225 Series

パッケージ  
Package DFN3030-10B

RoHS対応品 / RoHS Compliance  
ハロゲン&アンチモンフリー / Halogen & Antimony-Free

### IC部 / IC

No.	試験項目 Test Item	試験条件 Test Conditions	時間 Hours	試験結果 Result (r/n)
1	高温バイアス High Temperature Bias	125°C VIN=EN/SS=20V FB=0V PG=5V	1000	0/22
2	高温保存 High Temperature Storage	150°C	1000	0/22
3	温度サイクル Temperature Cycle (Gaseous)	-65°C~150°C 各30分 30min. each	100CYC.	0/22
4	プレッシャークッカーバイアス HAST	130°C85%RH 2×10 <sup>5</sup> Pa VIN=EN/SS=19V FB=1V PG=5V	100	0/22
5	はんだ耐熱 Resistance to Soldering Heat	85°C85%RH168h→reflow(150~200°C140sec/255°C30sec/260°C10sec)3times Moisture Sensitivity Level 1 Based on IPC/JEDEC J-STD-020	-	0/22
6	静電耐圧 Electric Static Discharge	MM R=0Ω C=200pF ±200V以上 R=0Ω C=200pF ±200V over	3回 3 times	0/5
		HBM R=1500Ω C=100pF ±1kV以上 R=1500Ω C=100pF ±1kV over	3回 3 times	0/5
		CDM ±500V以上 ±500V over	3回 3 times	0/5
7	ラッチアップ Latch-Up	R=0Ω C=200pF ±100V以上	3回	0/5
		R=0Ω C=200pF ±100V over	3回	0/5
		50mA以上 50mA over	3回 3 times	0/5

### コイル部 / Coil

No.	試験項目 Test Item	試験条件 Test Conditions	時間 Hours	試験結果 Result (r/n)
1	高温バイアス High Temperature Bias	85°C IDC=0.6A	1000	0/11
2	高温保存 High Temperature Storage	125°C	1000	0/11
3	高温高湿保存 Temperature Humidity Storage	85°C85%RH	1000	0/11
4	温度サイクル Temperature Cycle (Gaseous)	-55°C~125°C 各30分 30min. each	100CYC.	0/11

### パッケージ代表データ

Performed with samples that represent the applicable PKG type.

No.	試験項目 Test Item	試験条件 Test Conditions	試験結果 Result (r/n)
1	接合強度試験 Adhesive strength test	PKG側面を10N 10秒間加圧する (EIAJ ED7403) Apply a pressure of 10N on the side face of the PKG for 10sec.	0/5
2	基板反り試験 Bending Test	たわみ量 5mm 5±1s 1回/1time (EIAJ ED4702) Strain	0/5
3	はんだ付け性 Solderability	230°C10秒 (プロファイル昇温法) 230°C10s (Temperature profile method)	0/11